

适合 FPC 电子线路板的绝缘电泳涂装

可在铜基材导体上形成很薄的绝缘涂层，薄膜亦具有强力的可折弯性

■ 在铜导体上可形成 $5\ \mu\text{m}$ 的涂膜，使得基板更加薄型化。

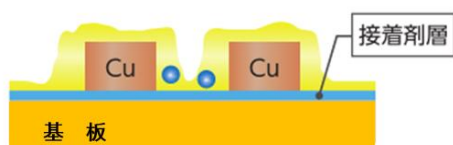
■ 对各种铜基材，可选择性的部分涂装。

■ 即便厚 $100\ \mu\text{m}$ 的厚铜也可以形成均匀的涂膜。

■ 不会与基层的粘合剂发生反应，能耐受各种弯曲和折弯不破损。

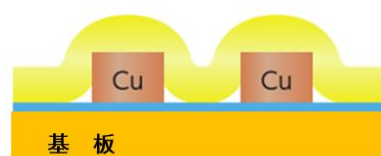
基材断面剖析图

● 印刷法涂装



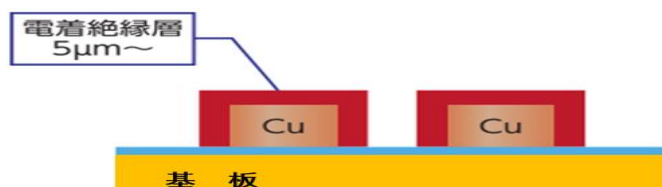
- 涂层的均匀性不好，很难薄膜化。
- 狭窄的地方容易混入空气。

● 贴膜法涂装



- 膜层都在 $15\ \mu\text{m}$ 以上，很难薄膜化。
- 狭窄的地方容易混入空气。

● 电泳法绝缘涂装



- $5\ \mu\text{m}$ 涂膜也能绝缘，可薄膜化。
- 防老化性能好。
- 可让铜等导电层部分绝缘。
- 具有良好的韧性及可折弯性。



株式会社 清水

电话：072-965-8888

传真：072-965-8889

地址：东大阪市加纳4丁目11番23号

上海分公司：希米主（上海）贸易有限公司

网址：<http://www.shimizu.com.cn>

电话：021-64325309

地址：上海市徐汇区虹漕路421号65号楼5楼E座